



## 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年7月26日

上場会社名 芝浦メカトロニクス株式会社

上場取引所 東

コード番号 6590 URL <http://www.shibaura.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 南 健治

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役経営管理部長

(氏名) 五十嵐 和彦

TEL 045-897-2425

四半期報告書提出予定日 平成23年8月9日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	9,785	1.5	△14	—	△13	—	△359	—
23年3月期第1四半期	9,641	101.7	△712	—	△728	—	△1,157	—

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 △348百万円 (—%) 23年3月期第1四半期 △1,163百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	△7.28	—
23年3月期第1四半期	△23.43	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	56,445	17,044	30.2
23年3月期	54,250	17,492	32.2

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 17,044百万円 23年3月期 17,492百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	0.00	—	2.00	2.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	—	4.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は定款において第2四半期末及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日毎の配当予想額は未定であります。

### 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	26,000	15.2	300	51.8	300	10.1	100	—	2.02
通期	54,000	16.8	1,300	74.9	1,300	61.7	900	85.3	18.21

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料P. 3「2. サマリー情報(その他)に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期1Q	51,926,194 株	23年3月期	51,926,194 株
② 期末自己株式数	24年3月期1Q	2,512,233 株	23年3月期	2,511,297 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期1Q	49,414,570 株	23年3月期1Q	49,415,886 株

#### ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項 .....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	3
3. 四半期連結財務諸表 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書 第1四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書 第1四半期連結累計期間 .....	7
(3) 継続企業の前提に関する注記 .....	8
(4) セグメント情報等 .....	8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	9
4. 補足情報 .....	10
(1) 地域ごとの売上高 .....	10

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

#### 業績全般について

当第1四半期連結累計期間における当社グループの事業環境は、円高などの影響から不透明な状況が続いています。液晶関連は大型テレビ用パネル関連設備の新規投資が停滞しており、また、高機能携帯端末用などのタッチパネル関連市場は活発化していますが、一部で投資が調整局面となっています。半導体関連は各デバイスメーカーの投資が継続しました。太陽電池関連は中国市場を中心に活発化してきています。

当社グループは受注活動の強化、事業構造の改善による固定費削減および標準化・リードタイム短縮などのコスト構造改革を進め、経営体質の強化に取り組んでまいりました。また、拡大する海外市場への取り組みを強化し、海外向け売上高比率が伸長しました。特に中国向売上比率は33%（前年同期22%）に増加しました。

このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高は9,785百万円（前年同期比1.5%増）、営業損失は14百万円（前年同期は営業損失712百万円）、経常損失は13百万円（前年同期は経常損失728百万円）、四半期純損失は359百万円（前年同期は四半期純損失1,157百万円）となりました。

#### セグメントの業績について

主なセグメントの業績は次のとおりであります。

##### ファインメカトロニクス部門

液晶分野では、高精細・中小型パネル設備投資は継続し、ウェットプロセス装置・セル組立装置などは堅調に推移しました。

半導体分野では、新たな高生産性枚葉ウェットプロセス装置を市場投入し、また、マスク関連装置の顧客拡大を図りました。

このような状況のもと、当セグメントの売上高は5,135百万円（前年同期比16.2%増）、セグメント利益は267百万円（前年同期はセグメント損失525百万円）となりました。

##### メカトロニクスシステム部門

液晶パネル分野では、モジュール工程のタッチパネル真空貼り合せ装置は設備投資が短期的な調整局面となり、受注は減少となりましたが、引合いは活発な状況です。また、大型パネルモジュール工程のアウトリードボンディング装置は投資の踊り場局面が続きました。

半導体組立分野では、新規顧客開拓に努め、先端デバイス用ダイボンダの顧客拡大を図りました。

太陽電池分野は中国市場を中心に顧客開拓を進めました。

このような状況のもと、当セグメントの売上高は3,810百万円（前年同期比10.9%減）、セグメント損失は339百万円（前年同期はセグメント損失229百万円）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

#### 資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,194百万円増加し56,445百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,560百万円増加し41,550百万円となりました。これは主に、現金及び預金が増加したことによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ365百万円減少し14,894百万円となりました。これは主に、リース資産の減少及び有形固定資産が減価償却により減少したことによります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,642百万円増加し39,400百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金、短期借入金が増加したことによります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ447百万円減少し17,044百万円となりました。これは主に、四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことによります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当社グループでは、夏期電力供給不足に対する電力使用抑制計画を実施中ですが、事業への影響を最小限とすべく対応を推進しております。

液晶パネル分野は、スマートフォンやタブレットPCなどの中小型パネル用設備投資が継続すると予想され、受注の拡大を図ります。また、大型パネル用の設備投資は不透明な状況が続くと予想されます。

半導体分野は、設備投資が堅調に推移すると予想され、受注の拡大を図ります。

また、コア技術を生かし、新分野の開拓を進め新製品の投入を図ります。

平成24年3月期の業績見通しとしては、売上高540億円、営業利益13億円、経常利益13億円、当期純利益9億円を予想しております。業績予想につきましては、業況の変化等により今後修正の必要が生じた場合は、適時かつ適切に開示してまいります。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、税引前四半期純利益に法定実効税率をベースとした年間予測税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,390	5,544
受取手形及び売掛金	26,939	27,260
商品及び製品	2,138	2,524
仕掛品	4,226	4,761
原材料及び貯蔵品	314	157
繰延税金資産	1,071	736
未収入金	714	365
その他	254	262
貸倒引当金	△60	△63
流動資産合計	38,990	41,550
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	28,822	28,235
減価償却累計額	△16,965	△16,851
建物及び構築物(純額)	11,856	11,383
機械装置及び運搬具	976	1,059
減価償却累計額	△786	△818
機械装置及び運搬具(純額)	190	240
工具、器具及び備品	366	366
減価償却累計額	△316	△302
工具、器具及び備品(純額)	50	63
土地	119	119
リース資産	1,751	1,635
減価償却累計額	△1,075	△1,062
リース資産(純額)	676	572
建設仮勘定	517	560
有形固定資産合計	13,410	12,939
無形固定資産		
のれん	49	44
特許権	205	233
リース資産	121	103
その他	414	494
無形固定資産合計	790	877
投資その他の資産		
投資有価証券	203	196
長期貸付金	1	0
破産更生債権等	0	0
長期前払費用	11	12
前払年金費用	319	310
繰延税金資産	180	179
その他	343	380
貸倒引当金	△1	△1
投資その他の資産合計	1,059	1,078
固定資産合計	15,260	14,894
資産合計	54,250	56,445

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,992	12,602
短期借入金	7,705	11,179
1年内返済予定の長期借入金	3,200	1,700
リース債務	380	320
未払法人税等	201	41
未払費用	2,626	2,117
前受金	435	610
役員賞与引当金	34	10
受注損失引当金	119	223
資産除去債務	11	11
その他	393	962
流動負債合計	27,100	29,779
固定負債		
長期借入金	500	500
リース債務	439	378
長期未払金	21	21
退職給付引当金	5,211	5,247
役員退職慰労引当金	23	5
修繕引当金	406	413
資産除去債務	31	32
長期預り保証金	3,022	3,022
固定負債合計	9,657	9,621
負債合計	36,758	39,400
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,761	6,761
資本剰余金	9,995	9,995
利益剰余金	2,426	1,967
自己株式	△1,719	△1,719
株主資本合計	17,463	17,004
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	30	23
為替換算調整勘定	△1	16
その他の包括利益累計額合計	28	40
純資産合計	17,492	17,044
負債純資産合計	54,250	56,445

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
売上高	9,641	9,785
売上原価	7,751	7,665
売上総利益	1,890	2,119
販売費及び一般管理費	2,602	2,134
営業損失(△)	△712	△14
営業外収益		
受取利息	0	1
受取配当金	1	1
受取賃貸料	25	25
固定資産売却益	—	53
負ののれん償却額	9	—
その他	26	27
営業外収益合計	65	109
営業外費用		
支払利息	47	48
為替差損	8	31
その他	25	27
営業外費用合計	81	108
経常損失(△)	△728	△13
特別損失		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	46	—
特別損失合計	46	—
税金等調整前四半期純損失(△)	△774	△13
法人税、住民税及び事業税	30	10
法人税等調整額	359	335
法人税等合計	389	346
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△1,164	△359
少数株主損失(△)	△6	—
四半期純損失(△)	△1,157	△359



(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	△1,164	△359
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	△22	△6
為替換算調整勘定	22	18
その他の包括利益合計	0	11
四半期包括利益	△1,163	△348
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,157	△348
少数株主に係る四半期包括利益	△6	—

## (3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (4) セグメント情報等

## 【セグメント情報】

## I 前第1四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	ファインメカ トロニクス	メカトロニク スシステム	流通機器 システム	不動産賃貸	合計
売上高					
外部顧客への売上高	4,418	4,277	490	454	9,641
セグメント間の内部売上高又は振替高	2	35	—	—	37
計	4,420	4,312	490	454	9,679
セグメント利益又はセグメント損失(△)	△525	△229	△77	186	△645

## 2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	△645
全社費用(注)	△69
その他	△12
四半期連結損益計算書の経常損失(△)	△728

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

## 3. 報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、当第2四半期連結会計期間より、従来、「ファインメカトロニクス」に含まれていましたフラットパネルディスプレイ製造装置のモジュール工程装置(アウターリードボンダ装置等)、半導体製造装置の組立工程装置(ダイボンダ装置等)をメカトロニクスシステム部門(旧名称電子・真空機器セグメント)に変更しました。これにより、従来、「ファインメカトロニクス」、「電子・真空機器」、「流通機器システム」および「不動産賃貸」の4つを報告セグメントとしておりましたが、これを「ファインメカトロニクス」、「メカトロニクスシステム」、「流通機器システム」および「不動産賃貸」の4つに変更しております。

この変更は、営業効率向上と人材の有効活用を図ることを目的とした事業部組織変更に伴うものであります。

## 4. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

## II 当第1四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年6月30日）

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	ファインメカ トロニクス	メカトロニク スシステム	流通機器 システム	不動産賃貸	合計
売上高					
外部顧客への売上高	5,135	3,810	407	432	9,785
セグメント間の内部売上高又は振替高	11	21	—	—	33
計	5,146	3,832	407	432	9,818
セグメント利益又はセグメント損失（△）	267	△339	△41	204	90

## 2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：百万円)

利益	金額
報告セグメント計	90
全社費用（注）	△83
その他	△20
四半期連結損益計算書の経常損失（△）	△13

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
該当事項はありません。(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記  
該当事項はありません。

## 4. 補足情報

## (1) 地域ごとの売上高

(単位：百万円)

		前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
国内		4,811 (50%)	4,092 (42%)
海外	北東アジア	4,240 (44%)	4,890 (50%)
	その他	589 (6%)	802 (8%)
	計	4,830 (50%)	5,693 (58%)
総計		9,641	9,785

(注) ( ) 内は構成比率